

請求の範囲

- [請求項1] フローはんだ工程でプリント配線板上の2つのランドにチップ部品の両端子電極をはんだ付けされるチップ部品の実装構造において、
前記チップ部品は、0.6 mm×0.3 mmの小型SMD部品であり、
前記2つのランドの間の寸法が、0.23 mm以上0.25 mm以下である、チップ部品の実装構造。
- [請求項2] 前記ランドの長手方向の寸法は、0.65 mm以上1.2 mm以下である請求項1に記載のチップ部品の実装構造。
- [請求項3] プリント配線板上の2つのランドにチップ部品の両端端子電極をはんだ付けするチップ部品の実装構造において、ランドへのパターンを引き込める形状、もしくは、ベタパターンの際にサーマルランドになる形状とする請求項1または2に記載のチップ部品の実装構造。
- [請求項4] 前記ランドは、凸部を有し、
前記ランドに接続される回路パターンは、前記凸部の形状に沿って前記凸部を介して接続される、請求項1または2に記載のチップ部品の実装構造
- [請求項5] 前記ランドは、少なくとも2つの凸部を有し、
前記プリント配線板上には、前記少なくとも2つの凸部にのみ接続されたベタパターンが設けられており、前記ベタパターンは前記少なくとも2つの凸部のそれぞれの凸部の形状に沿って接続されている、請求項1または2に記載のチップ部品の実装構造。